

# 合肥晶合集成电路股份有限公司

## 首次公开发行股票并在科创板上市

### 网上路演公告

**保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司**

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的应用已经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕954号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次初始公开发行股票数量为501,533,789股，发行股份占公司发行后总股本的比例为25.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至576,763,789股，约占公司发行后总股本的比例为27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行初始战略配售发行数量为150,460,136股，占初始发行数量的30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为280,859,153股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的80.00%，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的65.88%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量70,214,500股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的20.00%，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为145,444,500股，约占绿鞋全额行使后扣除初始

战略配售发行数量后本次发行总量的34.12%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2023年4月19日（T-1日）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网：<https://roadshow.cnstock.com/>

3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询。

敬请广大投资者关注。

**发行人：** 合肥晶合集成电路股份有限公司

**保荐人（主承销商）：** 中国国际金融股份有限公司

2023年4月18日

（此页无正文，为《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：合肥晶合集成电路股份有限公司



2023年 4 月 18 日

（此页无正文，为《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司



2023年 4 月 18. 日